## シリコンウェーハにおける自由キャリアの バルク・表面再結合拡散モデル: II. キャリア濃度分布

Diffusion model for bulk and surface recombination of free carriers in silicon wafer:

II. Carrier density distribution

九工大院生命体工<sup>1</sup>, 九工大工<sup>2</sup> 〇金田 寬<sup>1</sup>, 米澤 英晃<sup>2</sup>, 大村 一郎<sup>1</sup>

Kyushu Inst. Tech. <sup>°</sup>Hiroshi Kaneta, Hideaki Yonezawa, Ichiro Omura

E-mail: kaneta.hiroshi@ele.kyutech.ac.jp

一つ前の講演で我々が示した定常解*C*(*r*,*z*) の表式<sup>1)</sup>をウェーハの表面と裏面の状態が 同じ場合に適用して計算されたキャリアの等 濃度曲線を図1に示す. 図1(a)は、バルクラ イフタイム 1/a が無限大(高バルク品質の極 限)であり、かつ表面再結合速度 *p* が比較的 小さい場合である.これを基準にして *p* をモ デルの限界値(これは、表面準位密度の原子 論的限界値に対応する)まで高めた場合が図 1(b)である.この場合には、表面キャリア濃 度は事実上ゼロになっている.拡散のフラッ クスが等濃度曲線に直交することから、図 1(b)の場合には、図1(a)の場合に比べて、表 面に向かう拡散フラックス(拡散フラックス の表面垂直成分)が増大している.

図1(b) の場合を基準にして, バルクライフ タイム 1/a を低下させたのが図1(c) である. この場合, 半径方向の拡散長 $\sqrt{D/(a+p)}$ が減 少するため,等濃度曲線は全体的に中心軸(z軸)の方に向かって押しつぶされた形になっ ている.図1(b)や(c)で示したような等濃度曲 線の形状(ラグビーボール形)と符合するル ミネッセンス強度分布の観測データがRef.2 の図2とRef.3のFig.2(a)に示されている.

 金田,大村,2017年 応用物理学会秋季学術 講演会予稿集.

p=0.01 [1/µs] (a) 900  $a = 0 [1/\mu s]$ 0.25 600 300 1.0 -Beam axis 0 p=0.0389 [1/µs] (b) 900  $a = 0 [1/\mu s]$ 0.05 600 r (µm) 0.1 0.25 300 Beam 1.0 axis 0 p=0.0389 [1/µs] (c) 900 a = 1/38 [1/µs] 600 0.05 0.1 300 0.25 Beam 1.0 axis 0 200 300 0 100 387.5 µm z (µm) Surface

図 1. 自由キャリアを生成する YAG レーザビーム が厚さ 775µm のシリコンウェーハに定常照射され る場合の自由キャリアの等濃度曲線. 等濃度曲線 は,パラメター (*a*, *p*)の3種類の場合について 示されている. *z*軸はレーザビームの中心軸と一 致するように取られている. 等濃度曲線は,レーザ ビームの中心軸に近いところから,相対キャリア濃 度が 2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05, 0.02 のである 場合について書かれている.

- 2) 金田, 大村, 2016 年 応用物理学会秋季学術講演会予稿集, 15p-A23-9.
- 3) K. Moriya, Inst. Phys. Conf. Ser. No 135: Chapter 4, pp. 131-134 (1994).